

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本次募投项目的实际情况，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

### 一、发行数量

#### 调整前：

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000.00 万元。其中，国家集成电路基金认购金额占本次非公开发行募集资金总额的 90%，即不超过人民币 117,000.00 万元；湖南高新纵横认购金额占本次非公开发行募集资金总额的 10%，即不超过人民币 13,000.00 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至目前，上市公司总股本为 270,396,000 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 54,079,200 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息、事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根

据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如参与本次非公开发行的发行对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他发行对象可以优先认购该份额。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调减，但最高不超过 130,000.00 万元。国家集成电路基金、湖南高新纵横认购本次非公开发行股票认购金额将根据募集资金总额调减的比例相应调整。

### **调整后：**

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 108,800.00 万元。其中，国家集成电路基金认购金额占本次非公开发行募集资金总额的 90%，即不超过人民币 97,920.00 万元；湖南高新纵横认购金额占本次非公开发行募集资金总额的 10%，即不超过人民币 10,880.00 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至目前，上市公司总股本为 270,809,100 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 54,161,820 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如参与本次非公开发行的发行对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他发行对象可以优先认购该份额。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调减，但最高不超过 108,800.00 万元。国家集成电路基金、湖南高新纵横认购本次非公开发行股票认购金额将根据募集资金总额调减的比例相应调整。

## 二、募集资金金额及用途

### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 130,000.00 万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入高性能通用图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目、芯片设计办公大楼项目和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	高性能通用图形处理器研发及产业化项目	115,195.00	88,000.00
2	面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	18,760.00	12,800.00
3	芯片设计办公大楼项目	9,660.00	9,200.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		<b>163,615.00</b>	<b>130,000.00</b>

### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,800.00 万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入高性能通用图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	高性能通用图形处理器研发及产业化项目	115,195.00	88,000.00
2	面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	18,760.00	10,800.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>143,955.00</b>	<b>108,800.00</b>

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

董事会本次对发行方案调整的相关事宜需提交公司股东大会审议通过。

公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018年5月28日